

特 种 镀 层

上海市科学技术编译馆

表面处理技术译丛

特 种 镀 层

表面处理技术译丛编译组编

*

上海市科学技术编译馆出版

(上海南昌路59号)

商务印书馆上海厂印刷 新华书店上海发行所发行

*

开本 850×1156 1/32 印张 5 字数 190,000

1965年11月第1版 1965年11月第1次印刷

印数 1—3,600

编号 15·345 定价(科七) 0.90 元

目 次

1. 电沉积以外的金属镀覆方法……[美国] L. Maisel (1)
2. 气相镀概論……………[美国] C. E. MacNeill (12)
3. 蒸汽镀鉻研究……………[日本] 友野理平等 … (22)
4. 用真空蒸发的蒸汽镀……………[英国] B. J. Williams (30)
5. 用气相化学反应沉积金属膜层[英国] L. W. Owen ... (38)
6. 真空镀膜的結構及其性质……………[日本] 長倉繁麿 (52)
7. 电泳涂层的层…………… [苏联] ... (65)
8. 用电子射綫加层…………… [苏联] ... (75)

9. 电镀层的层…………… [苏联] ... (95)

10. 电镀层的层…………… [苏联] ... (104)
11. 电镀层的层…………… [苏联] ... (123)
12. 电镀层的层…………… [苏联] Levy ... (129)

13. 电镀层的层…………… [苏联] ... (151)

电沉积以外的金属镀覆方法

[美国] L. Maisel

金属膜层常被施加在各种表面上以提供下列的一项或几项特性：(1)裝飾性，(2)抗磨損用的接触面，(3)对腐蝕(产品污垢)的防护，(4)导电性或导热性，(5)增加反射率或映象的清晰度，(6)作为有机涂层的底层，(7)抗高温氧化的防护阻擋层，(8)易針焊性，(9)防止“咬死”。所有这些特性都可以归属于两大类型之一，即防护性或功能性，有許多則两者兼之。

有人說過，腐蝕(与一般看法相反)不是一个捉摸不定的命題，而是一种意義明确的現象；它是所有金属都必須在不同程度上得以遵守的一条規律，从而是金属或金属膜层的一种性质，犹如抗拉强度、延伸性等一样。正如各种性质会随着合金含量而变化那样，抗腐蝕能力或腐蝕敏感性也是如此。同样，正如我們可以从已知合金性质、某种設計原理和支配材料性质的規律来預知机械性能那样，我們也能从腐蝕的基本定律來估計腐蝕使用性能。由于目前已进行了大量的具有較大可靠性的研究工作，金属上面的腐蝕作用已不必經過詳細究考就能預測到一定程度的正确性了。

金属膜层通常可通过两种方式起到腐蝕的防护阻擋层作用。它能掩蔽基体金属使与所处环境隔开；如属多孔性或者由于环境侵蝕而变成多孔，它仍能保护基体金属，只要它的电化学位勢高于基体金属即行。在这种情况下，覆盖金属先行腐蝕，产生了一种电偶保护。例如，鋅和銻就能对鋼提供这种保护。绝大多数金属膜层的实际有效性都取决于孔隙的稀缺程度。較貴金属的多孔膜层，特別是銀、鉑和金，则事实上倾向于加速鋼的腐蝕。

近年来对不用电的金属镀覆法已产生了越来越多的兴趣。这些不同的镀覆方法，从文献和工业利用的概略調查看来还没有什么惊人的发展，但表明了工艺上的知識和改进在不断增长。某些方法可与电镀媲美，但工程材料費用之間的比較是成問題的；这特别是在比較各种膜层系統时是如此。所以在绝大多数情况下是不作費用比較的。

一、蒸汽沉积

蒸汽沉积 (Vapor deposition)、蒸汽镀 (Vapor plating) 和气相镀 (Gas

plating) 都是同一个意义，但不应与蒸发法(Evaporative process)(有时叫做蒸发镀膜或真空镀)相混淆。在蒸汽镀中，固体或液体膜层是用化学方法从接触基体的气体或蒸汽中产生。反应的促成，是由于使基体成为比气体较热(在某些情况下则是较凉)，从而扰动了气体中的化学平衡，以致发生反应，在基体上沉积出固体或液体。蒸汽沉积法能在远低于耐高温金属熔点的温度下，或者在耐高温金属的蒸汽压力小到可以略而不计的那种温度下，用来沉积大多数的耐高温金属膜层。在镀覆时间从几分钟到几小时的周期内，可以形成百分之几密尔到四分之一吋或更厚的膜层。蒸汽沉积法虽可极为优越地用于沉积耐高温金属和耐高温化合物，但也能使用于较不耐高温的材料，如铝、锡、铅、铁、铜和砷。

从工业利用来说，事实是：除了铬化和硅化以外，这个方法还处在发展阶段，多数成功的应用都是十分专门化的，并且是小规模的。一般采用的三种镀覆方法是：(1) 氢还原法，(2) 热分解法，(3) 置换镀。这些方法的具体介绍可见有关文献[1]。

这种膜层的性质，与同种材料的实体形式完全相同。在低温下沉积出来的晶粒是如此细小，以致膜层实际上是不定形的。相反，在高温下沉积出来的晶体，直径可达 $1/4$ 吋或更大，视膜层厚度而定。通常，厚度小于1密尔的膜层，晶体大小会随着膜层厚度而增大；平滑度则往往与基体表面差不多。对非金属杂质敏感的金属，能够被镀成为硬而脆的膜层，并且往往由于疏忽，在镀覆气氛中加入痕量的碳、氧、氮或氢化合物而造成如此。按照用途，用气相镀或蒸汽沉积法制得的膜层，厚度范围从百万分之几吋到 $1/4$ 吋或更大。用于防腐蚀或防氧化的膜层，通常在5~10密尔之间。制取厚度为1~2密尔的无孔膜层的技术，目前正在发展中。单单提供硬度和抗刻痕、抗磨损能力的膜层，为了获得某种挠性，一般不超过1密尔厚。低温沉积层与电镀层类似，也是机械地结合起来的。在低温镀覆中要获得牢固附着的沉积层，表面的仔细清理和除气是必要的。结合力还可用镀前侵蚀和喷丸的办法来进一步改善。高温沉积层能在膜层材料和基体的结合处产生一个扩散层，如果两者能够相互合金化或相互反应的话。这一扩散层往往能改善结合力，减低原始表面准备的重要程度。延展性良好的金属通常能在绝大多数不同基体上形成结合力极好的膜层。脆性金属往往只有在化学膨胀系数与之相接近和不经受变形的那些基体上，才能形成满意的膜层。脆性材料的透明膜层，比起结晶沉积层来，往往能显示出较大的强度和较大的抵抗热冲击能力。

这种方法在理想的条件下，较之其他的习用镀法有若干重要优点，即：

(1) 能沉积出电镀所不能达到或其他方法不能在无孔条件下获得的膜层。

(2) 能镀覆塑料和其他非金属之类的特种基体材料。气相镀几乎能用于凡属在工作温度下不熔化或不分解的任何材料上。

(3) 能镀覆不规则表面。

(4) 生产率高。在很多情况下，薄的膜层能在仅仅几秒钟或几分钟内镀得；通常，沉积速率约为每小时 1~2 密尔。

(5) 能制取超高纯度的金属和化合物。气相镀的沉积层，往往比从其他任何方法所得的沉积层更纯，这在合金研制和电子工业中很有用。

这种气相镀法的缺点如下：

1. 镀覆用的化合物有不稳定的倾向。它们相对地不稳定，易为空气或湿气所分解。所以这种化合物比其他镀覆技术所用的化合物要更贵、更难于贮存和处置。

2. 镀层可能不均匀。在气相镀中，10~25% 的厚度变化是常见的。由于不均匀加热能导致不均匀镀覆，所以为了获得均匀的热分布，在选择最好加热方法时，工件的形状和质量必须加以考虑。

3. 高温会改变基体的性质。气相镀中使用的高温会使得被镀覆的工件在性质上发生不希望有的改变。韧性丧失、晶粒变粗、尺寸变化和合金成分沉淀或进入溶液，这些都是会发生的改变。

4. 可能有不需要的副反应。从金属卤化物蒸汽中进行镀覆时，一个特别麻烦的反应是基体材料与卤化物蒸汽的相互作用，形成为基体材料或镀覆蒸汽的较低价卤化物。有些金属，如钽、铌和钛，对氢有强烈的亲和力。这些金属在氢气氛中镀过以后，必须经过真空退火或至少在惰性气体中冷却，以避免过度的吸氢作用。

二、真空镀膜

真空镀膜(Vacuum Metalizing)的原理，从实验室观点来说，五十年前就已经知道了。在工业基础上对金属、塑料和其他非金属施加蒸发金属膜的技术，大约有 25 年历史。真空金属膜层几乎对所有普通金属和非金属材料都能适用，使它们的外观和某些情况下的抗腐蚀能力得到改善。除用于非金属外，它们常被用于铜、锌之类的廉价金属。厚镀膜的应用，近来已扩展到了重载荷的功能性应用方面。真空镀膜的过程确实在高真空条件下进行的。一般地说，这个过程包括了将金属（往往是铝）加热到足够高的温度，使它的蒸汽压力显著地超过真空系统中的剩余压力。如此蒸发了的金属，会在冷表面上凝结下来，并且会在合适的条件下形成一个闪亮的金属般的沉积层。这一方法原先是为了成批生产而发展起来的；在这种生产中，饰物、玩具和装饰性零件是

放在挂具上，在蒸发时镀上金属。对于镀覆薄板材料，经济上要求镀膜操作应在卷材上完成。这可以在半連續或全連續操作中进行。

塑料零件的镀膜过程简述如下：要进行真空镀膜的零件必须先涂以清漆。把这一涂层作为底层。当底层经过固化或达到全无挥发性溶剂而不再逸出气体时，将零件与夹具装在一起放入真空室。在真空室中央，放有几股钨丝圈；钨丝圈的上面挂有铝的小弯条。钨丝与沿真空室中轴线同方向安装的几根电极相连接。钨丝的数量通常取决于被沉积金属的种类和所需的均匀程度。将真空室内的压力降低到0.5微米或更低，钨丝则加热到白炽状态，大约1200°F。铝即熔化并均匀地分布在钨丝上，然后将温度提高到1800°F，铝随后会蒸发。由于真空镀的膜层是非常薄的，约0.005密尔，它们能精确地复制出被镀表面，并且只有极小量固有的耐磨性。然而，把它施加在前述平滑的漆层上，却能够获得经久的镜面光亮膜。锡、铜、锌、硒和其他金属有时都用真空镀膜法来镀覆。在硒整流器的制造中，硒膜层（约3密尔）系镀覆在镀过镍的铝薄片上。

阴极溅射膜层是在真空中将高电压通过两根电极（其中的阴极由膜层材料组成）而获得。离子轰击使镀覆金属汽化，然后汽化金属冷凝在基体金属上，形成为结晶的、细粒的膜层。薄的膜层是高度多孔的，但也能获得厚约0.04密尔相当无孔的膜层。金和银的膜层能镀覆得最快。

三、浸镀——化学置换镀——热浸镀

浸镀和热浸镀的主要区别，仅仅在于：在浸镀中，基体金属是浸入含有镀覆金属的离子的水溶液中；而在热浸镀中，基体金属是浸入有融熔的镀覆金属的槽子中。两者都不需要电流，而膜层都比较均匀。由简单的置换作用（此时，镀覆金属的溶解电势低于基体金属）所制得的浸镀层，通常是十分薄的，因为沉积作用只有在基体金属暴露于溶液中的那段时间才能进行。较厚的镀层，有时可用化学还原法或使基体金属与比镀覆金属贱些的金属保持接触的办法来获得。用后一种办法，或者用调整槽液成分以倒转两种金属的溶解电势的办法，也有可能在更贵的基体金属上获得浸镀层。

在热浸镀中，结合力是由于镀覆金属会向基体金属中扩散和形成合金层而产生。绝大多数热浸镀层至少包含着两个不同的薄层：一个是合金层，一个是比较纯粹的镀覆金属层。合金层通常是脆性的金属互化物。热浸镀层（其中的合金层是比较厚的）是不易变形的，但现代技术有可能使合金层保持很薄。廉价金属的较厚镀层，能比电镀更便宜地用热浸镀来获得。然而，热浸镀层除了在简单形状上以外是很不均匀的，也浪费材料。这个方法的本质是：镀

覆金属限于熔点較低的金属，基体金属則限于高熔点金属（如鑄鐵、鋼和銅）。

用于保护鐵制品的热浸鋅层，由于具有高防腐蝕性和低成本的理想結合，多年来甚为流行。0.8~2 密尔或更大厚度的热浸鋅层已被用在很多商品上，如廢料桶、汽車消声器、水管和空气調节件。上述防腐蝕能力来自三个重要因素：(1)鋅的腐蝕速度比鐵慢，(2)它对鐵提供了电解保护，(3)鋅的腐蝕产物是白色的，比起鐵的黃銹来是不污染的。对腐蝕的防护程度，主要取决于鍍层重量——鍍层越重，基体金属的寿命越长。

热浸錫鍍层能用于軟鋼、合金鋼、鑄鐵、銅和銅合金制成的各种零件以改善外觀和抗腐蝕能力。同鋅和大多数其他热浸鍍层一样，热浸錫鍍层也由两个薄层組成，即一个比較純粹的外层和一个中間的合金层。在暴露期間，会有一层看不見的二氧化錫表面膜形成，它有助于減緩腐蝕，但不能完全防止腐蝕。这种鍍层在室內和大多数农村、海洋和工业大气中，具有良好的抗汚染变色能力。它們还能抵抗食品的侵蝕。薄鍍层十分普遍地用在食品加工中的罐头上。这种鍍层的厚度在 0.3~0.5 密尔之間。

热浸鉛或鉛錫鍍层能对黑色金属提供不少重要的好处。含有 3~8% 錫以及大約 12~20% 或更多錫的鉛錫鍍层，采用的厚度为 0.2~1 密尔或更大。这些鉛基鍍层用于屋面材料、彈药箱和导管。含 12~20% 以上錫的鍍层用于汽油箱、漆罐、油罐和門架上。它們都比較廉价而能提供良好的室内外大气腐蝕防护作用。它們的抗大气腐蝕能力来源于表面氧化膜的形成，这种氧化膜是相对地不受腐蝕的。鉛基鍍层所存在的一个問題是它們的結合力較差。

置換鍍层是錫、鎳、金、銀、銅和全部鉑族金属（包括鉻、銠、釤和鉑）。厚約 0.05 密尔的鎳置換鍍层，是用于鋼上作为搪瓷的底层，有时也作为进一步施加有机涂层之用。这个方法（即浸鍍）的主要优点，乃是对鋼件施加薄而均匀的鎳鍍层的一种廉价方法，并且在直流电得不到供应时也能采用。可获得的最大实用厚度，大約为 25 微吋；这是因为鍍覆速率会随着時間迅速降低，并且延长时间至 30 分钟（既沉积这一厚度所需的时间）以上也沒有什么好处。这种鎳鍍层是多孔的，但可进行热处理来减少孔隙和增加結合力。由于热处理能引起鐵和鎳的扩散，加热循环必須調整到能促进或避免扩散。例如，要是鍍覆的鋼面需用作有机涂层的底层的話，則在无氧化的氣氛中以 1200°F 处理 45 分钟就能产生良好的結果。

厚約 0.02~0.05 密尔的錫鍍层，能为黃銅、鐵和鋼的零件（如別針、頂針、回形針和鈕扣等）提供光亮裝飾性表面。鍍錫的主要优点是：容易操作，所需熟练技术比热浸鍍或电鍍少；經濟，不需要电气或其他昂貴設備；能沉积出极薄的均匀鍍层，因此少量的錫也大可一用。比上面所列的更厚的鍍层，系用来潤滑正在拉制中的鋼絲和正在跑合中的鋁活塞。大多數錫浸鍍方法是經驗性

的，按照被处理基体金属的不同，有不少的修改变化办法被采用着。

沉积鉻、鎆、釤和鉑分別到 50、30、100 和 65 微时厚度的滿意的浸鍍工艺，現在已經发展了出来。这些鍍层可用各种方法进行封闭，包括浸在沸水中、氫氧化銨中或置換金溶液中。在銅和某些銅合金上，已經沉积出既能对变色和腐蝕有防护作用，又能产生有效抗磨損能力的附着良好的鍍层。这种沉积法（即置換鍍），能消除印刷电路镀覆方面化学还原法的主要缺点，因为置換鍍层能圓滿地区別金属部分和非金属部分，但在这种情况下，一般的缺点是由于沉积金属的自行封闭作用，沉积层通常极薄。有人宣称，仅仅几个分子厚的鉻置換鍍层即能对銅提供相当大的防护值；这样极薄的鍍层大概不会对表面产生任何有效程度的抗磨損能力。从置換鍍法的本质可知，沉积层是通过向下生长而增大厚度的；所以鍍层的表面能在外形上和部位上十分精确地复制基体金属。从鍍液的寿命來說，鉻和鉑溶液的試驗表明，至少有 80% 的原始金属含量能在不妨害沉积速率或鍍层的一般质量和外觀下得到利用，只是有时全光亮度有所损失。目前，对于純銅以外的基体金属，置換鍍法的应用主要研究了鍍鉻。

銀浸鍍层已有采用，但比起上述其他鍍层来在程度上要少些。由于它的抗变色能力差，經不起随便滥用，因而用途局限于极廉价的裝飾目的和次要的电子零件。它們用在銅、鎳和鋼上的效果最好。

金浸鍍层有一个光亮的引人的外觀，这种外觀虽不十分經久，但能用一层清漆来保护。已有的主要浸鍍处理是用离子置換来沉积金，不含有游离氯化物。这些鍍层主要用于裝飾目的，如服装飾物、紀念品、汽車裝飾品和很多珍奇物品；它們还大量应用于电气設备上，如印刷电路、晶体管和电接头。这种应用的通常厚度約为百万分之一吋。

銅的化学鍍层(Electroless)往往比同样的电鍍层价廉。目前这种鍍层绝大多数用于印刷电路。虽然它們并不具有多少裝飾效用，但它們却用在某些廉价的裝飾性金属器皿上，并且由于它們的潤滑性能好，还被用在拉絲操作中的鋼絲上。鍍覆时间比电鍍要长些，取决于所需的厚度，厚度的范围一般为 0.1~1.0 密尔。

四、噴金属法——火焰噴鍍

噴金属法是把熔融金属噴射到表面上以形成膜层的一种方法。这一膜层的获得，是依靠了自动曳引金属絲穿过噴嘴，它在那里被火焰所熔化和被压缩空气流所雾化，压缩空气噴流又把这种微粒带向基体金属。在事先准备好的表面上，这种噴射积聚起来，形成为一层固体的金属膜层。由于熔融金属系由

大量的空气流所挟带，这种方法中的被镀工件就不会被加热到很高温度，所以称作“冷态”法。这些膜层还能采取粉末形式或熔融形式进行喷射，但应用不广。

金属喷镀能提供一种比较经济的选择性硬化方法。它们含有某些氧化物，膜层有受冲击变硬的倾向，往往具有优越的抗磨损能力。这些膜层可施之于所有普通金属和合金，包括铝、锌、铜基合金、镍、钼、软钢、高碳钢和不锈钢。结合力与一般镀层或热浸镀层是不相等的。这些膜层还十分多孔，具有贮油能力，使它们成为良好的轴承表面。喷射上去的金属，其成分在化学上和物理上都不同于原来的金属丝。一般说来，它比起同种金属的浇铸或锻制形式来要硬些、脆些和更多孔。

这一方法不能用在金属外露表面需承受激烈冲击、集中一点連續敲打或有严重边缘应力的地方。它能满意地用作轴承表面（如曲轴的），那里有相当的振动，但不是点接触而是全部轴承表面的接触。喷镀金属层在球轴承圈上是不能令人满意的。它在轴颈和其他各种磨损表面上则也是令人满意的^[2]。

金属喷镀层的用途（往往随后再加油漆），目前已被确定作为防护海洋大气中结构钢的一种经济方法。锌或铝的厚膜层能用来对付最恶劣的腐蚀条件，可以有15~20年的使用寿命而不需再作任何维修。在有硫化物的通常工业和酸性环境中，铝膜层目前已广泛地被认为在抗腐蚀能力上优于锌膜层。锌在许多碱性环境中是比较好的。在海洋条件下，铝在抗腐蚀能力上是长时期的优越的^[3]。

这一方法目前使用着许多不同金属：钼比起其他喷镀膜层来，对钢、铝和镁有较好的结合力，因为操作温度较高。这主要是由于对基体金属的轻微扩散，和由于汽化而除去了氧化物。因此，所需的表面准备工作较少，从而使得人们需要应用钼薄层来作为进一步喷镀用的底层。厚至1/8吋的抗磨损合金膜层的典型用途是：阀杆、电枢轴、活塞和泵叶片。喷镀用的其他金属包括：铜焊用的铜，接触面用的银，轴承表面用的锡和铅基巴氏合金。

五、化学镀——化学还原法

自从化学镀最初由 Brenner 和 Riddell 发现（原先是镀镍）以来，已有过大量的革新。目前，在铜、金、银和钯沉积层的领域内，大量的实验工作正在进行；它们系用在铜-塑料印刷电路上。

用化学还原法进行镀覆有很多优点，主要是这种镀覆有100%的均镀能力和膜层均匀性。镍沉积层还有其他的性质，如极高的硬度和在较高温度下

保持性能的能力。无限的均镀能力、膜层的均匀性和防护质量，使得这一方法可理想地用于铁合金、铜、黄铜、青铜和铝的不规则或复杂形状上，这些形状是不易或不可能用普通方法施镀的。

目前电子零件和导弹零件的小型化趋向，已使得在各种用途上采用金成了必要。对这一方法已作了大量的研究工作。据报道，要是基体金属经过高度抛光，膜层是光亮的，厚膜层则再需抛光。这些金沉积层据说比用其他方法得到的要密实些，所以较薄的膜层就能做同样的工作。这个方法适用于一大批金属和非金属材料。沉积的速度当然取决于很多因素，即温度和时间。

用化学催化法镀镍，与电镀的区别在于既不需要电流，又不需要电极。膜层是有相当硬度的低镍-磷合金，抗腐蚀能力高于电镀镍，并且镀出而未经加工的膜层即使厚度小于0.25密尔也是无孔的。

化学镀镍虽然主要用来防止腐蚀，但其他性能在许多用途上也是重要的。抗磨损能力往往也是影响决定化学镀选择的一个主要因素。在其他的例子中，考虑抗摩擦和抗擦伤就是主要的了。化学镀镍表面的润滑性有助于防止磨损、擦伤和划痕，特别是对于相互间产生滑动的零件。具有良好耐疲劳特性的钢件，用化学还原法镀镍，可用作承受动荷载的零件。化学镀镍层可用来减缓不锈钢的应力腐蚀，用来连接不同的铝合金和不同的铝合金，便利陶瓷与金属的连接，改善钢和不锈钢的钎焊性。它可以用来补救加工差错或毁损的零件，用来在钢上加镍以改善釉瓷的附着，以及用来在塑料和陶瓷上施加金属。化学镀镍还用来作为将银和其他电镀层附着于钛合金上的一种方法。当由于尺寸上的考虑而需要均匀的膜层厚度时，以及当低凹处或内表面的抗腐蚀能力不能用通常电镀技术得到时，化学镀镍层就比电镀镍层优先选用。与电镀层不同，化学镀在尖棱的边沿和角上不会增厚。

这一膜层是一种含磷6~10%的镍磷合金。它具有极细的晶粒——细到往往被当作是“不定形的”。它有高的硬度和低的延展性，刚镀出时的硬度在维氏500左右，在750°F下热处理30~60分钟可增高至维氏1000左右。

随着印刷电路的工业应用日益增长，已经形成了一种将电路图纹制在塑料板的两面以促使进一步节约空间的趋向。要在孔眼中沉积一层具有均匀厚度的薄的、导电的、稳定的膜层，化学还原镀法是许多方法中最适宜的方法。通过化学还原法来施加的最普通的金属是银，所用的方法是制镜工艺中多年来熟知的。然而，银在印刷电路中的使用，由于银的位移而有着局限性。对于沉积铜的电解方法已作了大量的研究工作。在印刷电路底板上制取镀膜的通孔，一种工业上成功的方法已于1956年研究了出来^[4]。

六、直接接触膜层——锤击法

用直接接触法——锤击法(Peening)或在金属粉末中滚动——进行镀覆，为人所知已有若干时候，专利只在六年前才颁发给这个方法。这一过程目前在工业上用于镀覆弹簧钢材料，如皮管夹头、弹簧垫圈和其他有关小零件。

这个方法基本上是在一个旋转滚筒内，将被镀的零件放在金属粉末，小块和小丸(作为锤击介质)，水，具有抑制剂的清洗剂或侵蚀剂(作为“促进剂”)中滚动。将密闭的滚筒旋转45~90分钟(视该装置所确定的镀覆速率而定)，粉末即在操作终了时几乎完全被锤击在欲镀零件上面。这就产生了一种冷态结合的表面，具有普通镀法所不可比拟的生产灵活性。这个方法主要适用于施加软的韧性的金属作为腐蚀防护层，如锌、镉、铅、锡和它们的合金。某些镀铝的研究工作目前正在进展。

除了比较便宜以外，其主要优点是没有氢脆，对许多金属的效率接近于100%。举一效率比较的例子，在热浸镀锌中，氧化损失就约有30%。采用这个方法，除了管理工作以外，只需要非熟练工人。膜层厚度可保持为十分均匀，视被镀零件的形状和大小，在0.0001~0.005吋之间。总的厚度变化约为5~10%，有极好的结合力。盐水喷雾试验的结果，表明在抗腐蚀能力上有某些变化，有的较好，有的较差；从所作少量测试的结果，表明抗腐蚀能力是比较好的。

用这个方法来镀覆的材料，最普通的是锌和镉。用锌时，零件清理是先去油，再酸蚀，接着浸镀铜层约0.00002吋厚，然后放入滚筒施镀。一个直径30吋、长30吋的滚筒，其典型的装载量为：1/16吋小块1200磅，18目钢丸200磅，零件400磅，锌粉8磅，再加上促进剂和水。以每分钟24转的速度将滚筒旋转90分钟，可得厚约0.0003吋的锌膜层^[6]。

这一方法有些局限性，即：

- (1) 狹小的缝隙不能镀上；大小和形状是限制因素。
- (2) 价格随着零件增大而增高，因为所需的滚动介质等较多。
- (3) 膜层材料限于软金属。
- (4) 基体材料也是有限制的，它们必须易于清理，但不太易于反应；这就排斥了钛、不锈钢和活泼金属如镁。

除了完全避免了氢脆的有害影响外，它还有如下的优点：

1. 不管形状的复杂性如何，膜层是均匀的。
2. 避免了由于烘焙而发生的膜层脱色现象。
3. 取消了老化处理：零件可立即使用。

4. 抗腐蝕能力良好(比較地)。

5. 經濟性好。

七、金屬氧化物施加后即行還原

用來沉積金屬膜層的另一種方法，是在欲鍍的表面上施加金屬氧化物，隨後在氬氣或還原氣體中以較高的溫度進行還原。一種典型的膜層可以用氧化鎳和磷酸氫二銨的混合物的高溫還原來制取。這個方法主要包括在被鍍零件上刷塗、浸上或噴上一層氧化鎳和磷酸氫二銨的水漿。然後將加上的水漿在空氣中乾燥，並在氬氣或還原氣體中還原。這個方法不需要溶液、特殊槽子或其他鍍覆設備，膜層則可施加於零件的任何局部部位或者任何大小或形狀，只要水漿能夠加上即可。這種特殊膜層的一個典型用途，是原油油船貨艙中的加熱盤管；對暴露於熱煙氣和燃煤蒸汽電站中的熱交換器管子也有顯著效果。

在這種膜層的加熱過程中，磷酸氫二銨和氧化鎳即與氬氣或還原氣體發生反應，形成為金屬鎳和一種鎳磷合金。對基體金屬也有某些鎳的擴散。例如，當施於鋼上時，膜層含有鎳、鐵和約3%的磷。膜層是十分延展性的，比化學鍍鎳只稍軟一點。這種膜層，由於它的熔點較低和自由流動的特性，可以用来進行銅焊。因此，在一次應用中，它就可以達到連接兩個或多個組件並獲得抗腐蝕膜層的雙重目的。

按這種方式施加的另一種金屬是銅，如施於冷卻器具的不銹鋼容器上。鋼件系先在空氣中加熱使之氧化，塗上氧化亞銅的溶液，然後在氬氣中加熱。銅即被還原成金屬狀態，並與基體金屬結合得很好。

八、規範要求

在擬訂金屬膜層的規範時，在描述膜層外觀的方法上有著極端的困難。在測量光澤和顏色的儀器方面，已進行了大量的研究工作，關於顏色方面已有固定標準如 Munsell 表示法、Tristimulus 數值等等。光澤測定研究已經完成，是以鏡面光澤來表示其量值的。這種測定符合於 ASTM D523，使用了一具光澤計來測量一條入射光束被表面反射出來的光線（其方向如同從鏡子反射出來那樣）。用顏色來作為鑑定金屬的方法是十分不清晰的，因為大多數金屬在顏色上是中性的，所以在 Munsell 系統上就過於接近中心點。這就使得規範鑑定只能以光澤作為決定性方向。另一個表面鑑定的方法，是用表面粗糙度。這往往用於經機械加工的金屬面，但也十分經常地用於先經機械加工再酸蝕過的金屬面上的那些鍍覆表面。在這方面已建立了非常明確的標準，

通常用表面粗糙度試驗計測定(一般把這當作結構組織看待)。

除了用外觀以外，確定膜層質量的規範還可採用其他指標，即：

1. 鍍覆厚度；
2. 膜層的抗腐蝕能力；
3. 對基體金屬的結合力；
4. 抗磨損能力；
5. 硬度；
6. 沉積膜層的成分；
7. 工藝上的特定具體要求；
8. 膜層的密度。

上列要求除了厚度和工藝上特定細節的某些情況外，極大多數都要破壞試樣。對這些要求的許多方面，ASTM 在建立仲裁方法上已進行了大量的研究工作，但在方法的再現性方面還有很多工作要做。

參 考 文 獻

- [1] Vapor Plating, C. F. Powell, I. E. Campbell, B. W. Gonser, 1955.
- [2] The Metalizing Handbook by H. S. Ingham and A. P. Shepard.
- [3] Welding Journal, p. 215~221 (Mar. 1959).
- [4] The Sylvania Technologist, p. 6~11 (Jan. 1959).
- [5] Electroplating and Metal Finishing, p. 247~251 (July 1960).

自《Metal Finishing》Vol. 60, No. 7 (1962) 32~43

孫旭輝譯

气相镀概論

[美国] C. E. MacNeill

气相镀(Gas plating)，即以气态化学反应来沉积金属、中间金属和陶瓷的方法，目前已成为一种形成新型独特镀层和材料的重要技术。最早的气相镀研究工作始于本世纪初期，当初是企图制取高纯度金属、镀层和各种化合物。在第二次世界大战时期，由于新型材料和代用材料的需要增长，气相镀在重新引起人们注意下有了发展。特别在技术较先进而原料缺乏的德国，更需研究新的材料。到了原子核和宇宙时代，看来更加明显：已有材料并不具备耐高温、耐侵蚀、耐腐蚀以及类似环境下所需的特殊性质。这就造成了对气相镀的新的兴趣，用来作为沉积特殊性质的镀层和生产超纯度金属及化合物的一种技术。在利用气相镀作为零件成型的一种方法(类似电铸法)方面，已进行了某些研究工作。除了“气相成型”法以外，气相镀还作为材料接合或“焊接”的新方法^[1, 2]。近十年来的发展证明，气相镀在材料的研究、发展和应用等方面具有很大潜力。

一、定 义

气相镀尚需给予定义，它意味着作为镀层的金属、陶瓷或其他化合物通过气态化学反应的沉积。不能用“蒸汽镀”这个术语；一般说来，蒸汽镀除了气相镀外，还包括真空镀和渗碳与氮化之类的扩散镀。但是，真空镀也可以包括气相镀，如果能使蒸发的金属或化合物与真空室中的剩余气体之间发生反应而在基体上生成不同成分的镀层的话。通常，真空镀主要是一个“物理过程”，仅包括材料的蒸馏和冷凝，而没有化学反应。所以，我们将研究用于气相镀的真空镀覆技术。

不包括气态化学反应的真空镀将不予考虑。包括气态化学反应的扩散镀(诸如铬的沉积和铬在基体中的扩散等等)将加以讨论。但不考虑那些仅在制备反应物时出现气体，而反应物本身却仍以固体状态存在的扩散镀。由于术语的界限混乱不清，所以应该不用“蒸汽镀”这个术语。同时，使用“气相”这个术语表明在气相镀过程中并存的若干反应物是均匀的；而“蒸汽”则表明它们的组成不是均匀的。

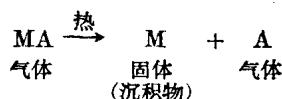
二、鍍覆反應

在氣相鍍中，反應的類型系依據操作過程中所用的化學藥品、零件的形狀及其用途而加以區分。最根本的是：反應物必須成為氣體，而這種氣體又必須能起化學反應，然後產生所需材料的鍍層，同時產生一種副產物。氣相鍍反應的類型如下^[3]：

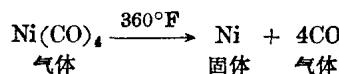
(一) 分解型

在分解型的反應中，反應物分解成兩種或兩種以上物質，例如：

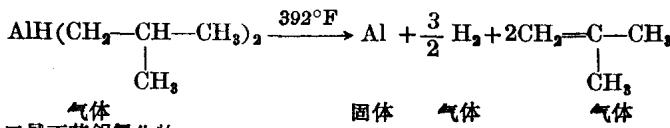
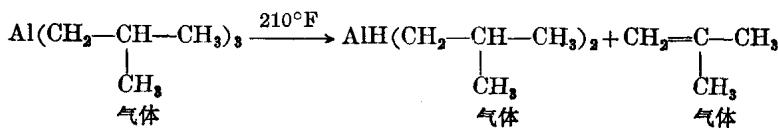
通式



鐵基鎳



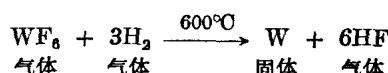
三異丁基鋁



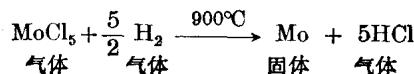
(二) 还原型

在還原型的反應中，氣體反應物與其他化合物作用，在零件表面上還原而成所需材料的鍍層。例如：

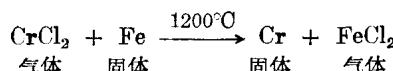
六氟化鈦



五氯化鉻



氯化鎘①



在绝大多数的情况下，镀覆反应的控制是关键性的，因为反应物不很稳定，同时也可能出现副反应。进行镀覆的操作条件必须小心控制。反应物过早的分解，将得到不合适的或不纯粹的镀层。副反应要沾污镀层，或者与被镀金属发生作用。通常，对于气相镀的各种材料的镀覆过程，都要作实验和分析。

在适当的操作条件下，气体化合物与热的零件接触会引起分解反应或还原反应，形成优质镀层。倘若长期地控制在适当的操作范围之内，则反应继续正常进行，从而获得所需厚度的镀层。有时，由于镀室中存在着外来微粒，催化反应物会引起副反应，致使镀层沾污。因此，镀室及有关装置通常要求高度清洁。基体材料也可能影响副反应，例如四羰基镍分解时，就有碳和碳化物与镍沉积物一起出现。气相镀层跟某些基体的结合能力，比与其他一些基体结合得牢些。例如钼沉积在铜上，其结合力就与它沉积在镍上的不一样。此外，还需要着重指出：用一个既定的方法，去镀一种新的基体材料，那末在镀前就要估

表 1 应用气相镀沉积的材料

① 这反应也可作为钢制品扩散镀铬时所起的置换反应^[4]。